

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen

Teil 6-3: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen
von SMD-Halbleitergehäusen – Messverfahren für QFP-Gehäusemaße
(IEC 60191-6-3:2000) Deutsche Fassung EN 60191-6-3:2000

DIN**EN 60191-6-3**

ICS 31.080.01

Mechanical standardization of semiconductor devices –
Part 6-3: General rules for the preparation of outline drawings of
surface mounted semiconductor device packages – Measuring
methods for package dimensions of quad flat packs (QFP)
(IEC 60191-6-3:2000);
German version EN 60191-6-3:2000

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –
Partie 6-3: Règles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs à montage
en surface – Méthodes de mesure pour les boîtiers plats
quadrangulaires (QFP) (CEI 60191-6-3:2000);
Version allemande EN 60191-6-3:2000

Die Europäische Norm EN 60191-6-3:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

Die EN 60191-6-3 wurde am 2000-11-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.4 „Gehäuse für Halbleiterbauelemente“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN IEC 47D/221/CDV:1998-08.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47D „Mechanical standardization of semiconductor devices“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2003 unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Fortsetzung Seite 2
und 14 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Nationaler Anhang NA (informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
–	IEC 60191-6:1990	–	–

Deutsche Fassung

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen

Teil 6-3: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen
von SMD-Halbleitergehäusen – Messverfahren für QFP-Gehäusemaße
(IEC 60191-6-3:2000)

Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 6-3: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages – Measuring methods for package dimensions of quad flat packs (QFP) (IEC 60191-6-3:2000)

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Partie 6-3: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs à montage en surface – Méthodes de mesure pour les boîtiers plats quadrangulaires (QFP) (IEC 60191-6-3:2000)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Electrotechnique Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 35 B-1050 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 47D/370/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 60191-6-3, ausgearbeitet von dem SC 47D „Mechanical standardization of semiconductor devices“ des IEC TC 47 „Semiconductor devices“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-11-01 als EN 60191-6-3 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2001-08-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2003-11-01

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60191-6-3:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 60191 legt ein Verfahren zur Messung von Maßen von QFP-Gehäusen fest, die als Form E klassifiziert sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC führen Verzeichnisse der gültigen Internationalen Normen.

IEC 60191-6:1990, *Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages.*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Teiles von IEC 60191 gelten die Definitionen nach IEC 60191-6.

4 Messverfahren

4.1 Die in dieser Norm beschriebenen Messverfahren sind für Maße, die dem Anwender auf der Grundlage folgender Punkte garantiert werden.

- a) Das Messen der Maße muss, was die Garantie für den Anwender betrifft, im Allgemeinen an einem Gehäuse durchgeführt werden, das auf einer Leiterplatte montiert ist.
- b) Die Messung darf im Allgemeinen entweder manuell oder automatisch durchgeführt werden.
- c) Falls ein festgelegtes Maß schwierig zu messen ist, wird das beste alternative Messverfahren als formelles Messverfahren definiert.
- d) Die Maße, die nach Zerstörung des Gehäuses nicht gemessen werden können, dürfen aus anderen Maßen berechnet oder durch entsprechende Werte ersetzt werden.

4.2 Eigenschaften und Darstellung

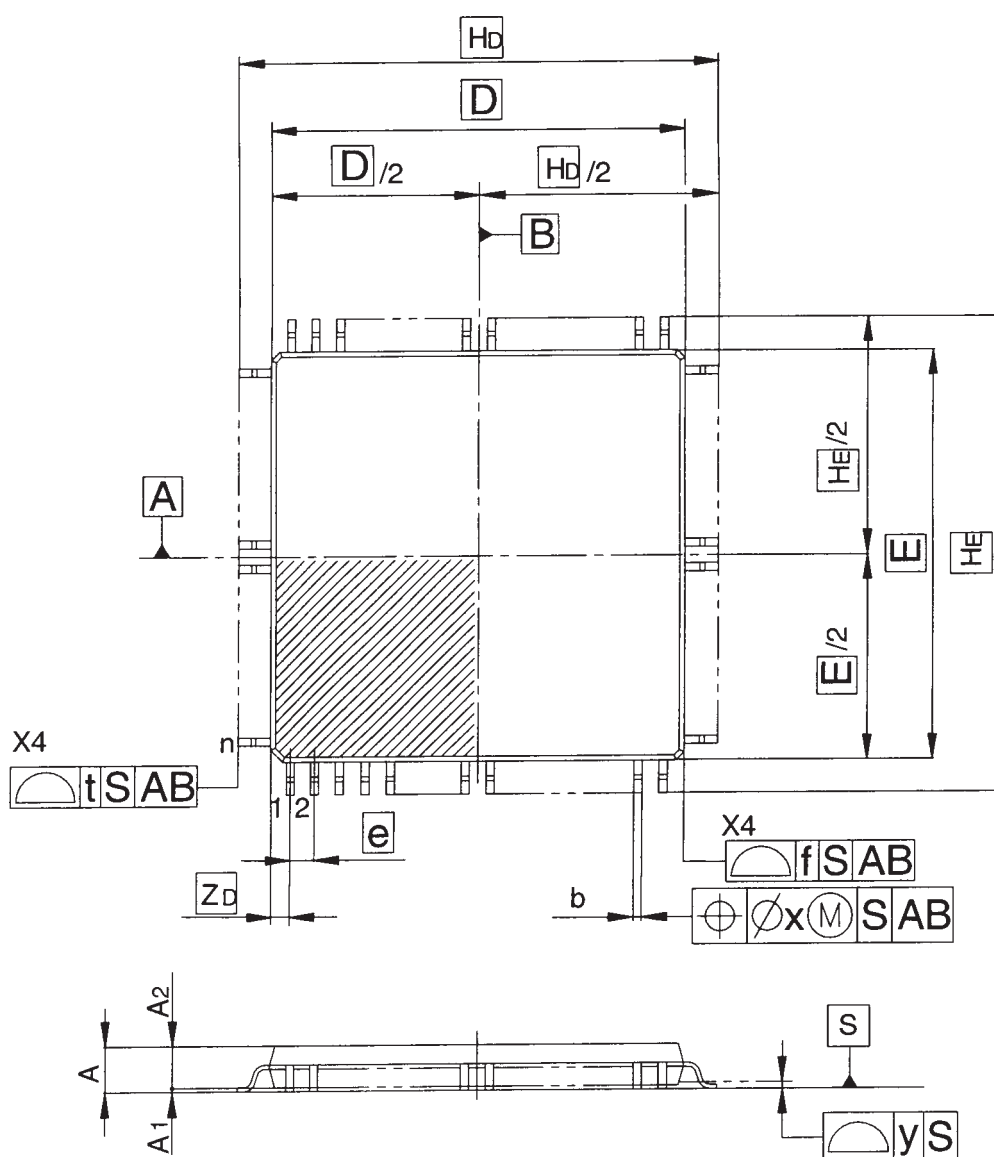


Bild 1